SEMICON Japan通信 2026 Vol.4

半導体
これまでの50年 これからの50年

12.9（水）- 11（金）東京ビッグサイトにて開催

SEMICON Japan 2026

来場登録受付中！

来場登録はこちら

APCS：AI時代を支える先端パッケージングの最前線！

AI時代を支える、先端パッケージングの最前線へ

AIの急速な進化とデータセンター需要の拡大を背景に、ますます重要性を増す先端パッケージング技術。
APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit) 2026では、データセンター、メモリ、ASIC、CPO、2.5D/3D実装、基板・インターポーザーなど、多角的な視点からその未来を探ります。展示、カンファレンス、ネットワーキング、教育講座を通じて、最新技術と業界のキーパーソンが集結します。

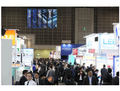
詳細はこちら

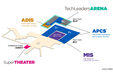
展示

最新技術・ソリューションが集結

アドバンストパッケージングやチップレットを支える、業界各社の最新技術・ソリューションが集結・小型化、低消費電力、高信頼性、低コストなど、多様化するニーズに応える技術を幅広く紹介します。今年は西ホール1階・4階にAPCS展示エリアを展開・「設計・検証」に特化したADIS展示エリアも隣接し、先端パッケージングを取り巻く技術を多角的にご覧いただけます。

日時：12/9（水）～12/11（金）
会場：東京ビッグサイト 西1-4ホール





カンファレンス

AIデータセンターの未来を、先端パッケージングから読み解く

AI性能をめぐる競争が、半導体単体からシステム・パッケージ・光配線を含む統合アーキテクチャへと広がるなか、AIインフラを支える先端パッケージングの役割に迫ります。CSPが描く次世代AIデータセンター像を起点に、演算処理、メモリ、接続技術をつなぐパッケージングの重要性を紹介・続くパネルディスカッションでは、「光か電気か」を切り口に、情報伝送技術の将来像や電力・熱マネジメントの課題を議論し、次世代AIインフラを支える実装技術の方向性を探ります。

Advanced Packaging and Chiplet Summit 2026
AIが変革するデータセンターの未来 ～CSPが求める先端パッケージング技術～
12/9(水) | 13:30 - 15:00
SuperTHEATER（会議棟1F レセプションホールA・B）

Advanced Packaging and Chiplet Summit 2026 パネルディスカッション
AI・データセンターを支える実装技術の最前線 ～光・電気・熱の最適解を探る～
12/10(木) | 15:30 - 17:00
SuperTHEATER（会議棟1F レセプションホールA・B）

Pick Up スピーカー






須藤 武文 さくらインターネット	Nitin Deshpande Marvell	富澤 将人 NTTイノベーティブデバイス	折井 靖光 Rapidus

テクノロジーセッション

3つの視点から先端パッケージングの最前線を深掘り

AI・HPCの進化とともに、重要性を増す先端パッケージング。APCSテクノロジーセッションでは、「エコシステム」「装置戦略」「基板・インターポーザー」の3つのテーマから、その最新動向と今後の展望に迫ります。CPOや2.5D/3D実装を支える企業・研究機関の連携・前工程で培われた技術を生かした装置メーカー各社の取り組み、さらに大型化・高機能化を支える基板技術まで、次世代実装を取り巻く技術と産業の動きを幅広く紹介します。

先端パッケージ領域を取り巻くエコシステム(CPO, 2.5D/3D実装)
12/9(水) | 11:30 - 13:00
TheSUMMIT（会議棟7階 国際会議場）

装置各社戦略
12/9(水) | 13:30 - 15:00
TheSUMMIT（会議棟7階 国際会議場）

先端パッケージ基板・インターポーザー
12/9(水) | 15:30 - 17:00
TheSUMMIT（会議棟7階 国際会議場）

Pick Up スピーカー






井上 史大 横浜国立大学	Andreas Schulze Applied Materials	Audrey Charles ラムリサーチ	三田野 好伸 東京エレクトロン

APCS-Next Presents: 宇宙と地球と半導体セッション

APCS-Next｜半導体の可能性は、地球を越えて宇宙へ

AIによる知能拡張や新産業の創出を支え、さらには宇宙へと活躍の場を広げる半導体・「Beyond Boundaries ～半導体が進化させる人・産業・宇宙～」をテーマに、人類と宇宙の未来、新たな産業の可能性、そして次世代を支える半導体技術を多角的に取り上げます。先端パッケージングやチップレット、新たなデバイスアーキテクチャなどの技術革新も交えながら、半導体がこれからの社会や産業をどのように進化させていくのか、その可能性を展望します。

宇宙と地球と半導体7.0 その1ー未来構想編
Beyond Boundaries～半導体が進化させる人・産業・宇宙～
12/11（金）9:30 - 11:00
TechSTAGE FUJI（会議棟 607-608）

スピーカー





中須賀 真一 立命館大学	若田 光一 アクシオムスペース	DECHAO GUO IBM

その他、業界最前線を網羅するセミナーも多数開催！

＼気になったセミナーはお気に入り★をクリック／

セミナー一覧はこちら

特集記事



SEMICON Japan 2026 未来を探る視点3
さらなる微細化・デバイス構造複雑化に向けた半導体新材料最前線

業界動向・SEMIの活動アップデート

ブログ



EDA市場成長の舞台裏とAIの影響 Griffin SecuritiesのJay Vleeschhouwer氏に聞く

市場動向



電子システム設計業界の2026年第2四半期売上高は57億ドル
ICフィジカル設計および検証・半導体IP、サービスが前年同期比で2桁の成長

SEMICON Japan 2026 スポンサー

Platinum Sponsors

DISCO　HIGHTEC SYSTEMS　HITACHI Hitachi High-Tech　SCREEN Innovation for a Sustainable World　TEL

Gold Sponsors

ADVANTEST　APPLIED MATERIALS　ASM　EBARA　FUJIFILM　JSR　KLA　KE KOKUSAI ELECTRIC　Lam RESEARCH　MJC　Nikon　Qnity　TERADYNE　ACCRETECH 東京精密

Silver Sponsors

JX金属　TOWA

Workforce Development Sponsors

HORIBA　muratec　SIMCO　TRENG

（10月28日現在、社名アルファベット順）

開催概要

半導体　これまでの50年　これからの50年

semi | SEMICON JAPAN 50

日　時：12月9日（水）- 11日（金）10:00 - 17:00
会　場：東京ビッグサイト
　　有明セントラルタワーホール&カンファレンス
　　TFTビル
費　用：展示会無料、セミナー一部有料

公式Webサイトはこちら

同時開催





